



2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2022年2月3日
東

上場会社名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所
 コード番号 5217 URL <https://www.techno-q.com>
 代表者(役職名) 取締役社長 (氏名) 園田 育伸
 問合せ先責任者(役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 岸 慎二 (TEL) 03-5354-8171
 四半期報告書提出予定日 2022年2月8日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2022年3月期第3四半期の連結業績(2021年4月1日~2021年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年3月期第3四半期	11,661	25.3	2,411	29.2	2,408	33.7	1,627	32.6
2021年3月期第3四半期	9,309	38.1	1,866	72.0	1,801	54.3	1,227	49.9

(注) 包括利益 2022年3月期第3四半期 1,991百万円(66.2%) 2021年3月期第3四半期 1,198百万円(90.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2022年3月期第3四半期	2,104.50	—
2021年3月期第3四半期	1,587.18	—

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第3四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2022年3月期第3四半期	16,852	12,991	77.1
2021年3月期	15,273	11,254	73.7

(参考) 自己資本 2022年3月期第3四半期 12,991百万円 2021年3月期 11,254百万円

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第3四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2021年3月期	—	0.00	—	330.00	330.00
2022年3月期	—	0.00	—	—	—
2022年3月期(予想)	—	—	—	330.00	330.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日~2022年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	15,000	17.3	2,800	14.5	2,760	16.5	1,940	20.8	2,508.32

(注) 1 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、上記の連結業績予想は、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2022年3月期3Q	780,000株	2021年3月期	780,000株
2022年3月期3Q	6,573株	2021年3月期	6,573株
2022年3月期3Q	773,427株	2021年3月期3Q	773,494株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足情報	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国及び世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況が続きました。足元では、新たな変異株（オミクロン株）の感染が報告され、しばらく落ち着いていた新規感染者数が増加傾向に転じるなど先行きは不透明であり、世界的規模の経済の持ち直しにはまだ時間を要すると予想されます。

半導体業界におきましては、5GやAI、IoT、自動運転等の需要がますます高まるなかで、半導体の供給不足による自動車減産の影響が関連業種へ波及し、生産のタイト感が強まってきております。こうした需給状況は当分続くものと思われ、コロナ禍における「巣ごもり需要」が引き続き期待されることや各メーカーの投資意欲も継続していることから、半導体市場は今後も着実に拡大していくものと見込まれます。

このような環境の中、当社では、これまでに蓄えた豊富な受注残高と、工場の高稼働に伴う量産効果を背景に、売上高、利益ともに計画を上回ることが出来ました。また、受注残高につきましては、2019年秋頃から拡大傾向に転じた後、コロナ禍においても拡大を続け、足元では引き続き過去最高レベルの水準で推移している状況です。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は11,661百万円（前年同期比25.3%増）、営業利益は2,411百万円（同29.2%増）、経常利益は2,408百万円（同33.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,627百万円（同32.6%増）となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等の適用により、当第3四半期連結累計期間の売上高は26百万円減少しております。

当社グループの事業は、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況の分析は省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,578百万円増加し16,852百万円となりました。主な要因は有形固定資産が1,571百万円増加したこと等であります。

負債合計は前連結会計年度末に比べ158百万円減少し3,860百万円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が119百万円が増加し、借入金が188百万円、未払法人税等が164百万円それぞれ減少したこと等であります。

純資産合計は前連結会計年度末に比べ1,736百万円増加し12,991百万円となりました。主な要因は利益剰余金が1,372百万円、為替換算調整勘定が372百万円それぞれ増加したこと等であります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,477,344	2,409,875
受取手形及び売掛金	3,344,309	4,214,068
製品	420,326	413,523
仕掛品	1,210,883	1,466,174
原材料及び貯蔵品	1,280,308	1,113,849
その他	144,667	253,221
貸倒引当金	△4,686	△1,439
流動資産合計	9,873,154	9,869,274
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,341,130	1,319,609
機械装置及び運搬具（純額）	1,523,999	1,500,289
土地	1,148,302	1,148,337
リース資産（純額）	183,193	159,703
建設仮勘定	551,914	2,202,358
その他（純額）	172,845	163,047
有形固定資産合計	4,921,383	6,493,345
無形固定資産	242,524	257,871
投資その他の資産		
その他	237,690	232,653
貸倒引当金	△876	△868
投資その他の資産合計	236,814	231,785
固定資産合計	5,400,722	6,983,002
資産合計	15,273,876	16,852,276

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	978,278	1,097,846
短期借入金	981,748	924,868
未払法人税等	499,286	334,710
賞与引当金	186,607	104,711
その他	366,623	438,111
流動負債合計	3,012,542	2,900,247
固定負債		
長期借入金	681,081	549,930
役員退職慰労引当金	26,944	33,707
退職給付に係る負債	133,066	149,164
その他	165,477	227,770
固定負債合計	1,006,568	960,572
負債合計	4,019,111	3,860,819
純資産の部		
株主資本		
資本金	829,350	829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260
利益剰余金	9,174,802	10,547,249
自己株式	△38,026	△38,026
株主資本合計	10,981,386	12,353,834
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△2,222	△10,510
為替換算調整勘定	275,600	648,133
その他の包括利益累計額合計	273,377	637,623
純資産合計	11,254,764	12,991,457
負債純資産合計	15,273,876	16,852,276

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年12月31日)
売上高	9,309,773	11,661,491
売上原価	6,486,472	8,132,368
売上総利益	2,823,300	3,529,123
販売費及び一般管理費	956,685	1,117,330
営業利益	1,866,614	2,411,792
営業外収益		
受取利息	1,089	566
受取配当金	950	1,170
保険返戻金	933	5,609
その他	5,467	3,478
営業外収益合計	8,441	10,824
営業外費用		
支払利息	7,388	6,962
為替差損	63,710	5,955
その他	2,866	1,628
営業外費用合計	73,965	14,546
経常利益	1,801,090	2,408,070
特別利益		
固定資産売却益	—	101
特別利益合計	—	101
特別損失		
固定資産除却損	3,929	17,680
特別損失合計	3,929	17,680
税金等調整前四半期純利益	1,797,161	2,390,491
法人税、住民税及び事業税	528,011	670,047
法人税等調整額	41,478	92,765
法人税等合計	569,489	762,813
四半期純利益	1,227,671	1,627,678
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,227,671	1,627,678

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
四半期純利益	1,227,671	1,627,678
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△6,499	△8,287
為替換算調整勘定	△22,455	372,532
その他の包括利益合計	△28,954	364,245
四半期包括利益	1,198,716	1,991,923
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,198,716	1,991,923

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

当社グループは半導体事業の単一セグメントであります。

① 生産実績

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	11,513,466	27.9

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 金額は消費税等を含んでおりません。

② 受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	12,466,883	31.7	5,007,615	32.9

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。

③ 販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	11,661,491	25.3

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。